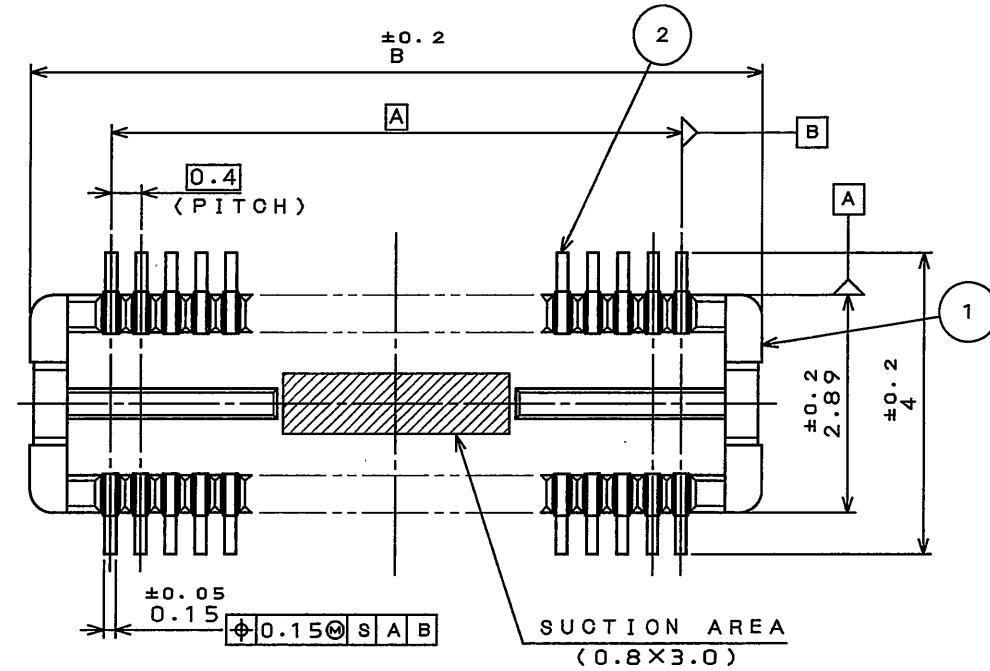


SJ102172
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	20.0ct.2005	058478	CHANGED FORM		R.KATOU		K.HISATOMI
3	3.Mar.2006	059496	ADDED ITEM		H.OBIKANE	M.KIMURA	K.HISATOMI
4	5.Feb.2009	067369	ADDED ITEM		H.MATSUZAKI	H.OBIKANE	Y.YAHIRO
5	20.0ct.2009	068825	ADDED WORD		H.MATSUZAKI	H.OBIKANE	Y.YAHIRO
6	12.Jul.2010	070310	ADDED ITEM		H.MATSUZAKI	H.Obikane	T. Harada



DESIGNATION

命名法

WH1P***WA1

SERIES
シリーズ

CONNECTOR FORM P:PLUG
コネクタ形状 P:プラグ

NUMBER OF CONTACTS
芯数

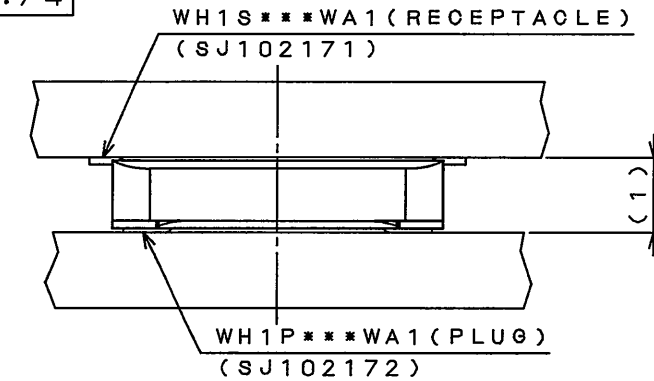
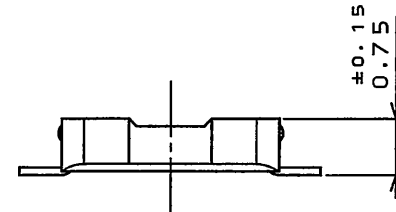
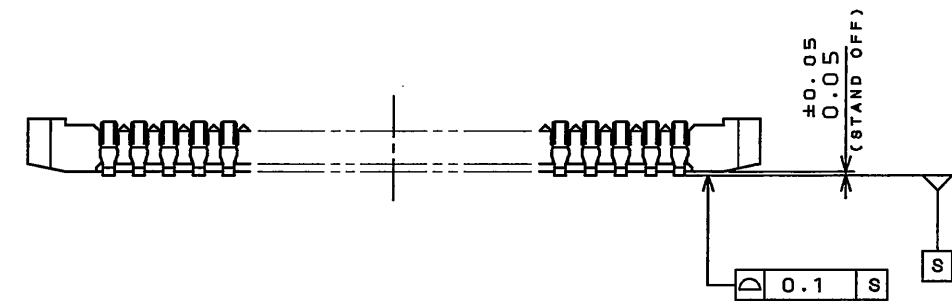
MODIFY CODE
モディファイコード

CONTACT FINISH A:GOLD PLATING(0.1μm MIN) (CONTACT AREA) Δ
コンタクト仕上げ A:金0.1μm以上 (接触部)

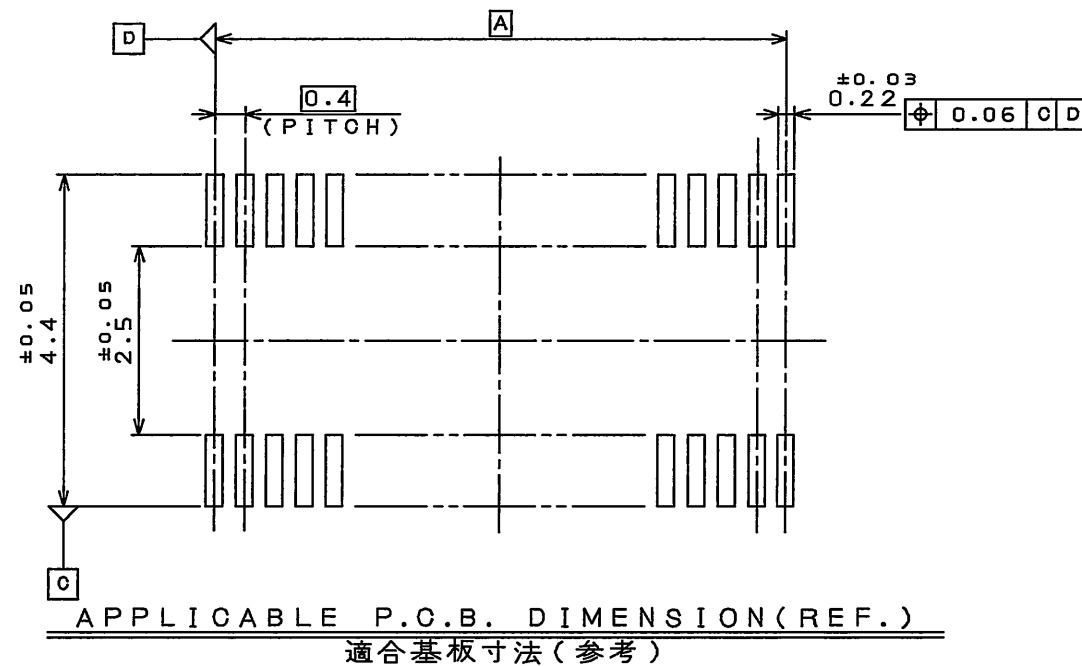
W:SMT, STRAIGHT TYPE, WITHOUT HOLD DOWN
W:SMT,ストレートタイプ,ホールドダウン無し

TABLE 1

名称(TITLE)	A	B
WH1P024WA1	4.4	6.54
Δ WH1P030WA1	5.6	7.74
Δ WH1P040WA1	7.6	9.74
Δ WH1P050WA1	9.6	11.74
Δ WH1P060WA1	11.6	13.74



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)



符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
2	CONTACT	N	COPPER ALLOY	CONTACT AREA GOLD PLATING(0.1μm MIN)	
1	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JACS-10255-*		30.Aug.2005		10: 1	WH1
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)	
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)		担当 CHK. R.KATOU		WH1P***WA1 (PLUG)	
. ±0.8 X° ±		査閲 APPD. M.KIMURA		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
.X ±0.4 X°X' ±		承認 APPD. K.HISATOMI			
.XX ±0.1 XXX ±					
				質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.)
					SJ102172
					版数 (REV.)
					6

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

